



SPRS TECHNOLOGIES

产品特点

- 高精度胶片处理技术
- 高性能，低温漂，大功率
- 陶瓷基板，共面波导50Ω输出
- 金丝键合，适用于多芯片集成模块

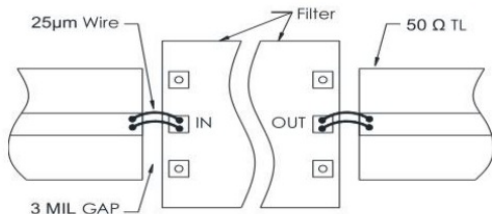
技术要求, $T_A = 25^\circ\text{C}$

参数	最小	典型	最大	单位
中心频率		10.55		GHz
工作频率	9.0		12.1	GHz
中心损耗		1.8	2.3	dB
带内波动		0.85	1.0	dB
回波损耗	12	13.5		
带外抑制	@5.9-7.8GHz	40	45	dBc
	@13.7-14GHz	40	45	dBc
	@DC-5.9GHz	50	55	dBc
	@14-26GHz	50	55	dBc

环境要求

最大输入功率	35	dBm
工作温度	$-55^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$	
储存温度	$-55^\circ\text{C} \sim +125^\circ\text{C}$	

推荐装配图



注意事项:

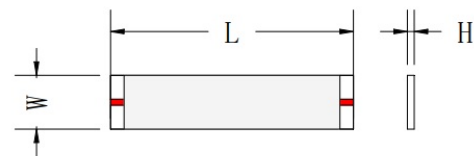
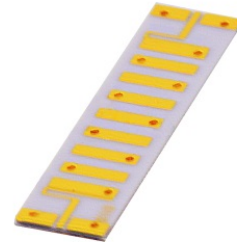
1. 芯片建议分腔使用，单侧距侧壁**0.1mm**，表面距上盖**2.75mm**，芯片端口可互换；
2. 芯片推荐使用低应力导电胶(如 ME8456)粘接；
3. 芯片应安装在可伐（推荐）或钼铜等与陶瓷热膨胀系数 ($6.7\text{ppm}/^\circ\text{C}$)，载体厚度 $\geq 0.2\text{mm}$ ；
4. 电路板微带线与芯片键合连接时，建议微带键合处采用T型结构进行匹配，T型尺寸如下：

电路板 Rogers 5880, 10mil 厚	电路板 Rogers 4350, 10mil 厚
注：T型图形顶端基板白边0.1mm；频率10GHz以下无需匹配	

P/N: STBP106-3R1-D297

Thin Film Planar Filters

外形图



外形尺寸	L	W	H	单位
	8.0	3.5	0.254	mm

典型曲线, $T_A = 25^\circ\text{C}$

